****

|  |  |
| --- | --- |
| **Domande dei lettori:** | **Contatto Stampa:** |
| **congatec AG** | **SAMS Network** |
| Christian Eder | Michael Hennen |
| Phone: +49-991-2700-0 | Phone: +49-2405-4526720 |
| [info@congatec.com](mailto:info@congatec.com)  [www.congatec.it](http://www.congatec.it) | [info@sams-network.com](mailto:info@prismapr.com)  [www.sams-network.com](http://www.sams-network.com) |



*Le nuove schede in formato Thin Mini-ITX di congatec con processori Intel® Core™ di sesta generazione saldati garantiscono scalabilità di prestazioni e integrano memorie RAM DDR veloci*

*Testo e foto disponibili presso:* [*http://www.congatec.com/press*](http://www.congatec.com/press)

**Comunicato stampa**

**Prestazioni scalabili con le nuove schede Thin Mini-ITX per uso industriale di congatec con processori Intel® Core™ di 6a generazione saldati a bordo**

**La scalabilità di queste schede ne permette l'impiego in un'ampia gamma di applicazioni industriali**

**Deggendorf, Germania, 23 Febbraio 2016 \* \* \*** congatec, azienda leader nel settore dei moduli di elaborazione embedded, dei computer su scheda singola (SBC - Single Board Computer) e dei servizi EDM (Embedded Design and Manufacturing), presenta una nuova famiglia di schede in formato Thin Mini-ITX con processori Intel® saldati caratterizzate da un elevato grado di scalabilità. Queste schede sono disponibili in modelli che possono ospitare un'ampia gamma di processori, dai processori Intel® Celeron® a 2 GHz fino ai dispositivi Intel® Core™ i7 a 3,4 GHz. Tra le altre caratteristiche di queste schede, destinate all'uso in applicazioni industriali, si possono annoverare le seguenti: TDP (Thermal Design Power) configurabile da 15 a 7,5 W, possibilità di ospitare fino a 32GB di RAM DDR4 e supporto di più display con risoluzione 4K. A corredo è disponibile una ricca dotazione di interfacce che garantisce una connessione diretta con dispositivi specifici come ad esempio schede SIM, telecamere CMOS a basso costo e sportelli automatici. Design particolarmente robusto per garantire il funzionamento in ambienti gravosi e disponibilità sul lungo periodo (per almeno 7 anni) sono le altre specifiche di rilievo di questo schede. Per gli OEM tutto ciò si traduce in una maggiore semplicità in fase di integrazione (design-in) e una maggiore efficienza, in termini di tempo e costi, del processo di sviluppo di un prodotto.

Grazie alle loro doti di scalabilità, le nuove schede conga-IC170 in formato Thin Mini-ITX sono ideali per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni industriali. Tra queste si possono menzionare interfacce operatore (HMI) prive di ventole, sistemi di controllo e SCADA, chioschi o sistemi per punti vendita, slot machine e cartellonistica digitale (digital signage). Grazie a un design "piatto" (lo spessore è di appena 20 mm), queste schede possono anche essere utilizzate per lo sviluppo di pannelli di comando estremamente sottili o PC di tipo "All-in-One" industriali. Il modulo, opzionale, per la gestione della batteria (SMART BATTERY) permette di utilizzare queste nuove schede anche in applicazioni portatili alimentate a batteria come ad esempio nelle apparecchiature mobili a ultrasuoni impiegate nel settore medicale. Grazie al controllore per la gestione della scheda integrato e al supporto per la tecnologia Intel® vPro™ con Intel® AMT (Active Management Technology) è possibile incrementare l'affidabilità delle installazioni di sistemi IoT distribuiti e, in molti casi, evitare il ricorso alla manutenzione "on-site".

**Uno sguardo in profondità**

Le schede conga-IC170 in formato Thin Mini-ITX sono equipaggiate con le versioni SoC dual core serie U dei processori Intel® Core™ di sesta generazione. Si va dalla versione base con processore Intel® Celeron® 3995U (2 GHz) a quelle con processori Intel® Core™ i3 6100U (2,3GHz) e i5 6300U (2,4GHz, 3GHz in modalità turbo) per arrivare ai modelli con processore Intel® Core™ i7 6600 con una frequenza di clock massima di 3,4GHz (in modalità turbo). In funzione del tipo di processore utilizzato, le nuove schede sono caratterizzate da un TDP configurabile da 15 a 7,5 W in modo da soddisfare i requisiti in termini di dissipazione della specifica applicazione considerata. Grazie alla presenza di due zoccoli SO-DIMM, le nuove schede possono supportare fino a 32 GB di memoria RAM DDR4/2133 MHz in modo da assicurare un'ampiezza di banda nettamente superiore e una maggiore efficienza energetica rispetto alle implementazioni con RAM DDR3 tradizionali.

La grafica Intel® Gen9 integrata supporta DirectX 12 e Open GL 4.4 per garantire elevate prestazioni grafiche 3D su un massimo di 3 display indipendenti con risoluzione 4k (3840 x 2160 pixel) a 60 Hz attraverso 2 interfacce DP++ e 1 interfaccia eDP: inoltre è prevista la possibilità di configurare un'interfaccia LVDS a 24 bit a due canali. E' altresì disponibile il supporto della codifica e della decodifica accelerate via hardware di video HEVC, VP8, VP9 e VDENC.

Oltre a 4 slot PCIe (Gen 3), la gamma di interfacce disponibile comprende 1 porta mPCIe oltre a un connettore M.2 che può essere utilizzato per l'espansione o per un SSD. Sono inoltre previste 4 porte USB 3.0 e 6 porte USB 2.0 per il collegamento di periferiche aggiuntive; 2 porte Gigabit Ethernet e uno zoccolo per scheda SIM per garantire la connettività in applicazioni IoT ed M2M e un'interfaccia MIPI CSI-2 per il collegamento diretto di telecamere CMOS a basso costo.

Tra le altre interfacce utili nelle applicazioni industriali si possono segnalare 2 porte COM, una delle quali può essere configurata come ccTalk e 8 GPIO. In opzione è disponibile un modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato. Dischi rigidi e SSD possono essere connessi attraverso 2 porte SATA 3.0, mentre è prevista anche un'interfaccia per audio 5.1 HD e digital audio.

Per quanto concerne i sistemi operativi, le nuove schede supportano tutte le più diffuse versioni di Linux e Microsoft Windows – compresa Windows 10. La vasta gamma di accessori finalizzata a semplificare la fase di integrazione – dissipatori di calore, pannelli di I/O e set di cavi – completa l'offerta di congatec.

Ulteriori informazioni relative alle nuove schede conga-IC170 in formato Thin Mini-ITX sono disponibili all'indirizzo: <http://www.congatec.com/en/products/mini-itx/conga-ic170.html>

**Chi è congatec AG**  
congatec AG ha sede a Deggendorf, in Germania, ed è fornitore leader di computer monoscheda (SBC), servizi EDM e moduli informatici industriali che utilizzano fattori di forma standard Qseven, COM Express, XTX e ETX. I prodotti congatec possono essere utilizzati in molteplici settori e applicazioni, tra cui l'automazione industriale, la tecnologia medica, le forniture per il settore automobilistico, aerospaziale e dei trasporti. Il suo principale campo di competenza e know-how tecnico comprende esclusive funzioni BIOS estese, così come pacchetti completi di supporto per driver e schede. Successivamente alla fase di progettazione, ai clienti viene fornita assistenza tramite una gestione estesa del ciclo di vita del prodotto. I prodotti dell'azienda sono fabbricati da fornitori di servizi specialistici conformemente ai moderni standard di qualità. Attualmente congatec vanta 177 dipendenti e divisioni a Taiwan, Giappone, Cina, USA,  Australia e Repubblica Ceca. Per ulteriori informazioni consultare il nostro sito web [www.congatec.com](http://www.congatec.com) oppure tramite [Facebook](http://www.facebook.com/Congatec), [Twitter](https://mobile.twitter.com/congatecAG) e [YouTube](http://www.youtube.com/congatecAE).

\* \* \*